

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hội thảo khoa học

Ứng dụng vật liệu nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển

Kính gửi: - Quý thầy/cô, các nhà khoa học, nhà quản lý;
- Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.

Để góp phần định hướng, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành chip bán dẫn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: **Ứng dụng vật liệu nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển**. Hội thảo là nơi công bố kết quả nghiên cứu khoa học về vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong điện tử và quang điện tử; trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn. Trường ĐHSP Hà Nội 2 xin trân trọng kính mời Quý thầy/cô, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tham dự Hội thảo với những thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích của Hội thảo

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học về vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong điện tử và quang điện tử; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp chip bán dẫn; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Nội dung chính của Hội thảo

- Các báo cáo khoa học về vật liệu cấu trúc nano; linh kiện điện tử, quang điện tử nano;
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và định hướng phát triển tại Việt Nam.

3. Thành phần tham dự

- Đại biểu là báo cáo mời;
- Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các thầy/cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và mọi người quan tâm;
- Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Hội thảo

- Thời gian: 8h00 ngày 23/12/2023.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp



- Địa điểm: Hội trường nhà A1, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Lê phí tham dự hội thảo và đăng bài: Miễn phí.

6. Thể lệ, thời gian, địa chỉ gửi bài:

Thể lệ gửi bài:

- Bài tham dự Hội thảo được trình bày dưới dạng một bài báo khoa học gồm các phần chính sau: Tiêu đề; họ và tên các tác giả; cơ quan công tác; tóm tắt; các từ khóa; nội dung (thường gồm các phần Giới thiệu, Thực nghiệm, Kết quả & Thảo luận, Kết luận); tài liệu tham khảo (được trình bày theo chuẩn IEEE). Bài báo toàn văn không dài quá 10 trang (bao gồm tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất trên khổ giấy A4, phông chữ: Times New Roman (Unicode), giãn cách dòng: 1,15 lines, cỡ chữ: 13. Cuối bài có ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email của tác giả.

- Các báo cáo tham gia Hội thảo sẽ được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Những báo cáo có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn giới thiệu đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ISSN: 2815-5837). Thông tin chi tiết đăng bài trên tạp chí của Trường tại website: <https://sj.hpu2.edu.vn/index.php/journal>.

Thời gian gửi bài: Bài toàn văn gửi trước ngày: 17 tháng 12 năm 2023.

Địa chỉ gửi bài: E-mail: hoithaokhoahoc@hpu2.edu.vn

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Hường - chuyên viên Phòng KHCN&HTQT trường ĐHSP Hà Nội 2, email: nguyenthihuong@hpu2.edu.vn, điện thoại: 0969389083

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hiệu trưởng (đề b/c);
- Lưu: TCHC, KHCN&HTQT.



Bùi Kiên Cường